

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-008

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司控股子公司海盐中达金属电子材料有限公司（以下简称“中达金属”）生产经营及业务发展的需要，中达金属拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函、贸易融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。在授信期限内，额度循环滚动使用。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

二、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025年2月28日